

## 鼎芯正式发布 TD 射频芯片

[2006-10-30]

《第一财经日报》昨日获悉，由鼎芯半导体研发的全球首颗 TD 标准手机 CMOS 射频芯片日前在“国际固态电子电路大会”(ISSCC)上正式公布。

鼎芯是 TD-SCDMA 产业联盟核心芯片厂商，也是 TD 国家射频专项、科技部“863”计划射频芯片项目的独家承担企业。“这还是 ISSCC 有史以来首次公布中国本土射频芯片。之前一提到‘射频’两字，国外同行就不屑一顾。”鼎芯公司总裁陈凯对记者表示，这标志着中国 TD-SCDMA 产业链已从根本上实现自主。

此前，尽管中国创立了 TD-SCDMA 这一国际标准，但因射频与基带芯片完全依赖国外企业，因此，这块技术短板直接影响了 3G 政策的提前开放。

事实上，早在今年 4 月份的测试中，鼎芯就成功实现了 TD-SCDMA 网络的通话。最新产品已是优化版，在与国外产品测试对比中，在工艺、功耗、成本以及与本土 TD-SCDMA 联盟的共生关系深度上，都拥有明显优势。中国 TD-SCDMA 产业联盟秘书长杨骅表示，截至目前，鼎芯的芯片是唯一能支持展讯、凯明、T3G 和重邮等所有国内基带芯片厂商接口的本土产品。

不过，在刚结束的第三阶段 TD 首轮测试中，记者没有在芯片厂商中发现鼎芯的名字。陈凯表示，本轮测试的重点是基站与网络，而非手机射频，明年第一、第二季度，公司产品将成为测试的重点。

这似乎意味着明年上半年，本土厂商仍将忙于测试，3G 牌照仍将难以发放。陈凯对此避而未答，他表示，作为 TD 联盟成员企业，公司将在 3G 开放前做足商用化准备，目前除了在技术上用力，在生产制造上也已和台积电公司达成战略合作，以期在 3G 开放后，迅速出货。